

株式会社東京精密 2023年度(2024年3月期) 決算説明会

2024年5月10日

代表取締役会長 CEO	吉田 均
代表取締役社長 COO	木村 龍一
代表取締役副社長CFO	川村 浩一
取締役 計測社カンパニー長	塚田 修一

◆ **将来の事象に係わる記述に関する注意**

- 本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- 従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

◆ **表記データ・用語について**

- 注記がある場合を除き、**半導体製造装置セグメント**を「半導体」、**精密計測機器セグメント**を「計測」、また**親会社株主に帰属する当期純利益**を「当期純利益」と記載します。
- 記載されている金額や比率の情報は、注記がある場合を除き、億円またはパーセントによる要約表示を行っております。その為、内訳の計が、合計と一致しない場合があります。
- 2022年度より、在外子会社の収益及び費用は、従来 of 期末レートから期中平均レートにより円換算する方法に変更しております。これに伴い、補足資料の2021年度の数値は、期中平均レートを遡及適用した数値を記載しております。

◆ **監査について**

- 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

次第

- ◆ 2023年度 業績説明
- ◆ 2024年度 業績予想
- ◆ 2022-2024年度 中期経営計画 2年目 総括
- ◆ 質疑応答

2023年度 連結業績



通期業績(億円)	2022年度				2023年度				予想対比	前期比
	通期				通期					
受注高	1,363				1,209				-	-11%
売上高	1,468				1,347				+17	-8%
営業利益 (営業利益率)	345 (24%)				253 (19%)				+3	-27%
経常利益	353				265				+7	-25%
当期純利益	236				194				+14	-18%
1株配当	235円				192円				+14円	-43円

四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	前年同期比
受注高	462	340	301	260	295	299	301	312	+4%	+20%
売上高	279	432	320	437	266	369	254	458	+81%	+5%
営業利益 (営業利益率)	57 (20%)	100 (23%)	74 (23%)	114 (26%)	43 (16%)	71 (19%)	30 (12%)	109 (24%)	+264%	-4%
経常利益	65	101	71	116	47	74	30	114	+282%	-2%
当期純利益	48	71	33	84	32	53	21	88	+324%	+5%

- 民生エレクトロニクス需要の低迷が長期化し 前期比で減収減益
- 予想対比では、第4四半期に計画通りの出荷を実施し、若干上回る水準で着地

May 10th, 2024

Copyright 2024 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

4

- 代表取締役社長COO の木村です。日頃大変お世話になっております。
- では説明に入らせていただきます。
2023年度の業績は、上段に記載の通りです。
全体として、民生エレクトロニクス需要の低迷が 想定以上に長期化し
前期比で減収減益の着地となりました。
- 第4四半期の業績は、下段に記載の通りです。
概ね 計画通りに出荷・据付が進み、第3四半期比 大幅な増収増益、
想定を若干上回る着地 となりました。
- この結果を受け、通期配当予想を、1株あたり192円へ変更いたしました。
詳細は、本日の適時開示をご覧ください。

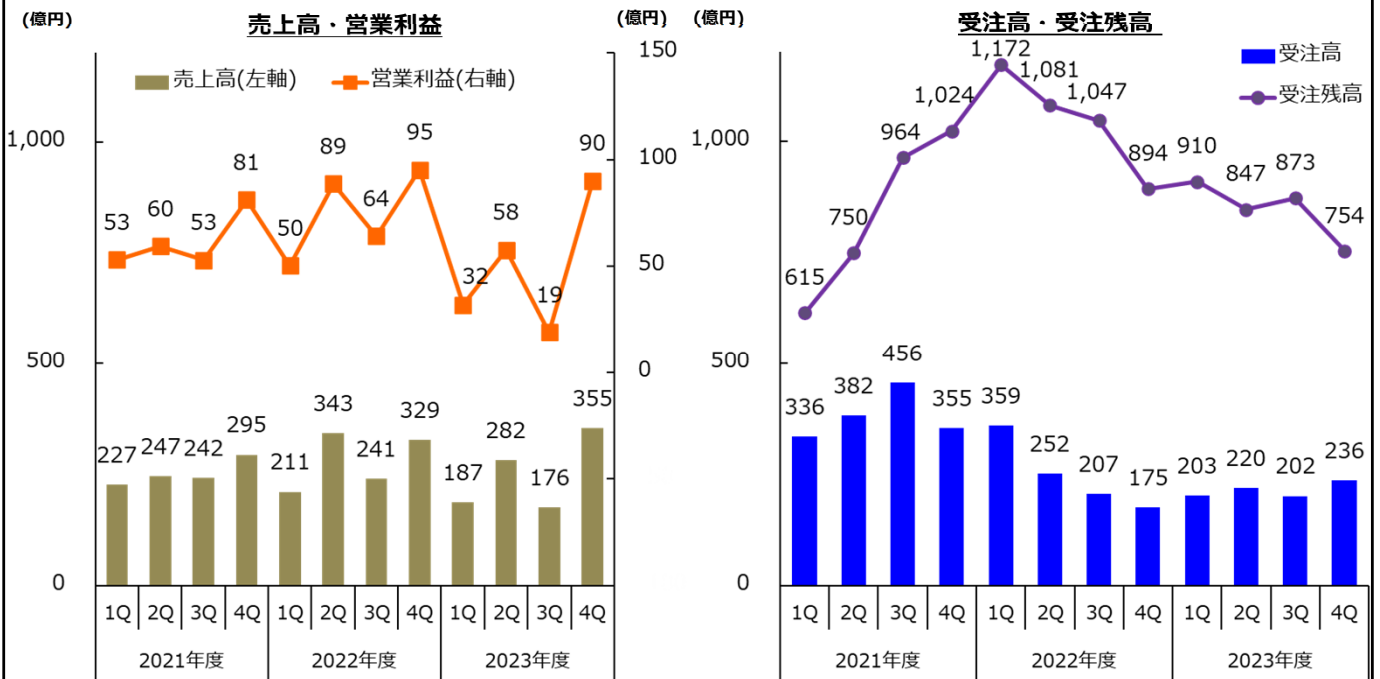
セグメント業績 (通期：億円)	2022年度		2023年度		
	通期		通期	予想対比	前期比
受注高	994		861	-	-13%
売上高	1,124		1,001	+6	-11%
営業利益 (営業利益率)	299 (27%)		199 (20%)	-	-33%

四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	前年同期比
受注高	359	252	207	175	203	220	202	236	+17%	+35%
売上高	211	343	241	329	187	282	176	355	+102%	+8%
営業利益 (営業利益率)	50 (24%)	89 (26%)	64 (27%)	95 (29%)	32 (17%)	58 (20%)	19 (11%)	90 (25%)	+371%	-5%

- 民生エレクトロニクス関連受注が低迷したものの、生成AI等の受注が下支え
- 売上高・営業利益は、想定範囲内での着地

- 次に、半導体製造装置セグメントの説明です。
2023年度実績はご覧の通りです。
- 上段、通期受注ですが、
民生需要が軟調だったことで、特に台湾OSATの引合いが低調でしたが、
その一方で、生成AI、SiC、イメージセンサ、中国マーケットなどが比較的堅調に推移し、
前期比で軽微な減少となりました。
- また、第4四半期に、出荷・据付が進んだことで、
売上高、営業利益は 想定範囲内で着地いたしました。
- 四半期業績は、下段に記載の通りです。

半導体 - 四半期業績推移



- 売上高・営業利益：第4四半期に大幅な増収増益、生成AI関連売上も計上
- 受注・受注残高：想定を若干上振れる着地

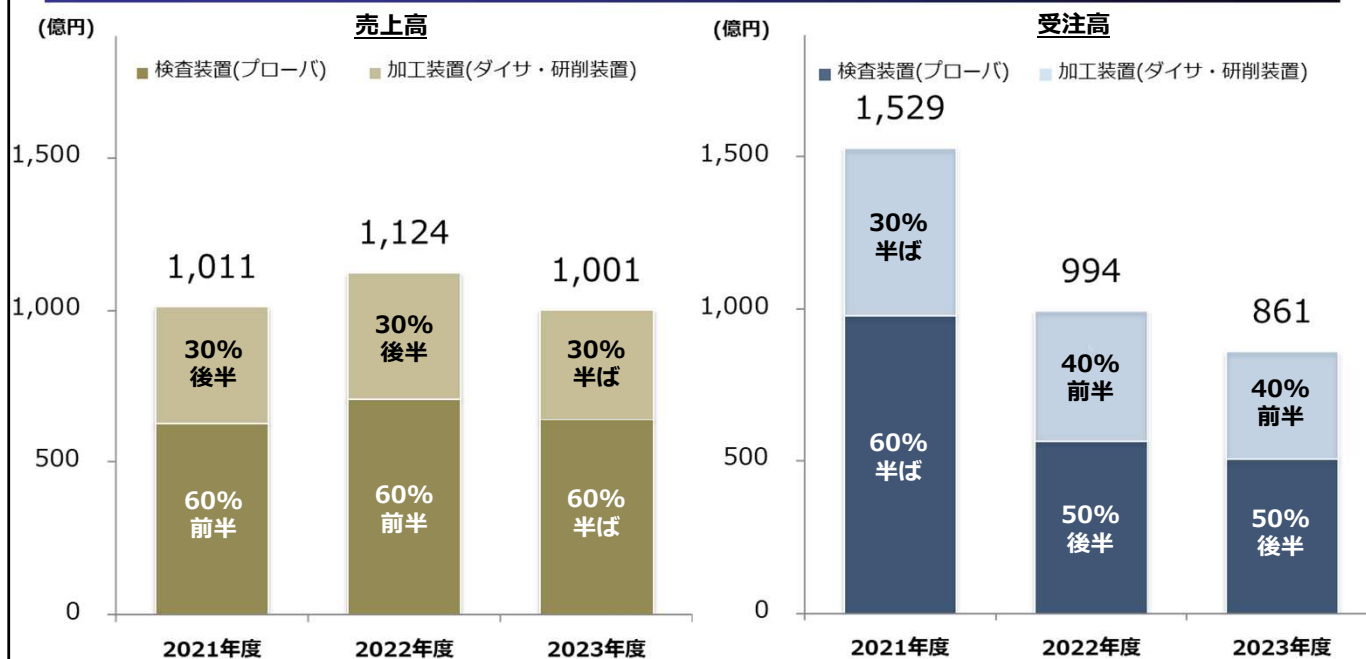
May 10th, 2024

Copyright 2024 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

6

- 半導体、売上高などの四半期推移です。
- 左側、売上高・営業利益のグラフですが、先ほど申し上げた通り、第4四半期に大幅な増収増益となりました。なお、生成AI関連の売上が、第4四半期に50億円強計上されております。
- 右側の受注高グラフ、第4四半期ですが受注済案件の精査を行い、10億円強の取消処理を行いました。
- その一方で、生成AI関連の受注が計画を若干上振れたこと、などにより想定を1割程度上振れる着地となりました。

半導体 - 製品別動向



➤ 製品別動向に 大きな変化は無い

○ こちらは半導体の 製品別売上高、並びに受注高です。

○ 製品別動向に大きな変化はございません。加工装置の受注が相対的に安定しています。

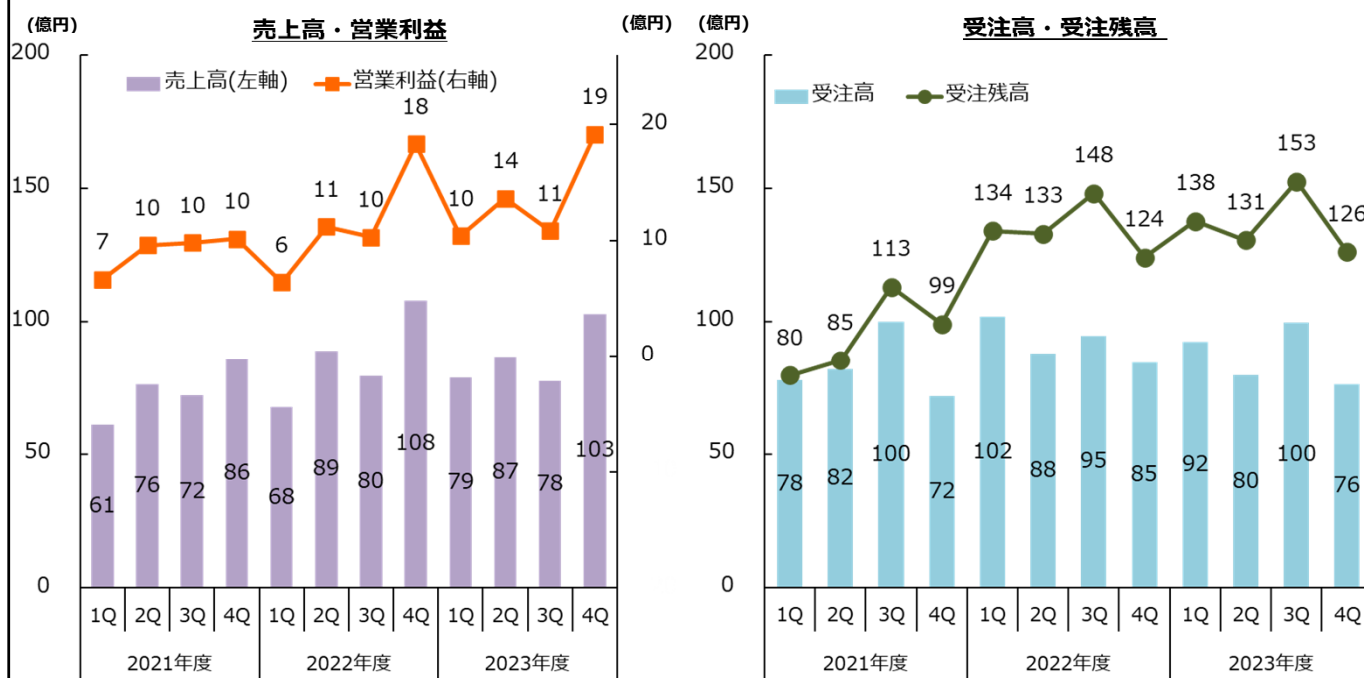
セグメント業績 (通期：億円)	2022年度				2023年度				予想対比	前期比
	通期				通期					
受注高	370				348				-	-6%
売上高	344				346				+11	+1%
営業利益 (営業利益率)	46 (13%)				54 (16%)				-	+17%

四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	前年同期比
受注高	102	88	95	85	92	80	100	76	-23%	-10%
売上高	68	89	80	108	79	87	78	103	+32%	-5%
営業利益 (営業利益率)	6 (10%)	11 (13%)	10 (13%)	18 (17%)	10 (13%)	14 (16%)	11 (14%)	19 (19%)	+77%	+4%

- 設備投資先送り傾向により、受注高は減少
- 売上高は 前期並みで着地

- 次に、計測機器セグメントの説明です。
2023年度業績はご覧の通りとなります。
- 通期受注高は、製造業全般、特に工作機械の設備投資先送り傾向により、前期比で減少となりました。
- しかしながら、売上高は、非自動車向けの計測機器の販売強化や、一部製品価格の改定などにより ほぼ前期なみとなりました。
- 営業利益率も製品価格の改定と、コストダウンにより改善いたしました。
- 四半期業績は、下段に記載の通りです。

計測 - 四半期業績推移



➤ 売上高・営業利益：2022年度の製品価格改定効果により、前四半期比 増収増益

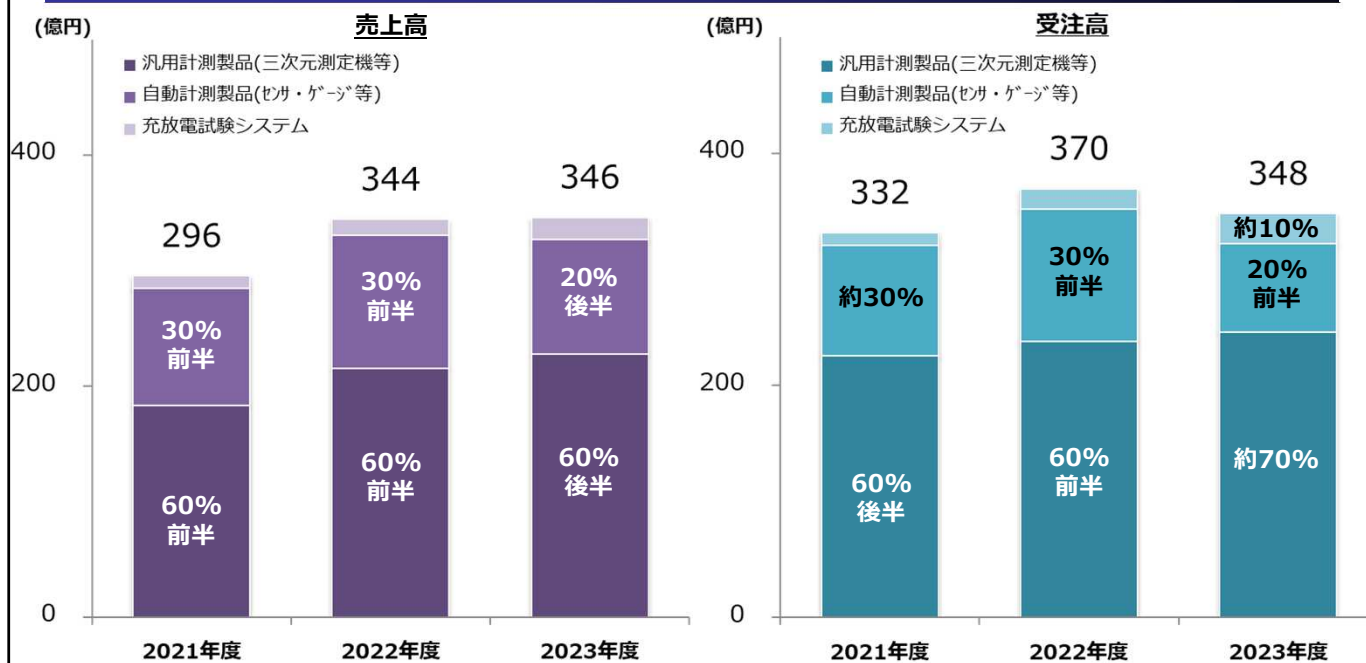
➤ 受注・受注残高：季節性・駆け込み需要からの反動減で減少

○ こちらは計測の四半期推移グラフです。

○ 左側、売上高と営業利益の推移ですが、
第4四半期は 出荷・据付が想定通り進んだほか、
2022年度に価格改定を行った製品の売上が進んだことで増収増益となりました。

○ 右側、受注高ですが、
第4四半期は、季節性による減少に加え、
価格改定前の駆け込み需要からの反動減がありましたが、ほぼ想定内の着地となりました。

計測 - 製品別動向

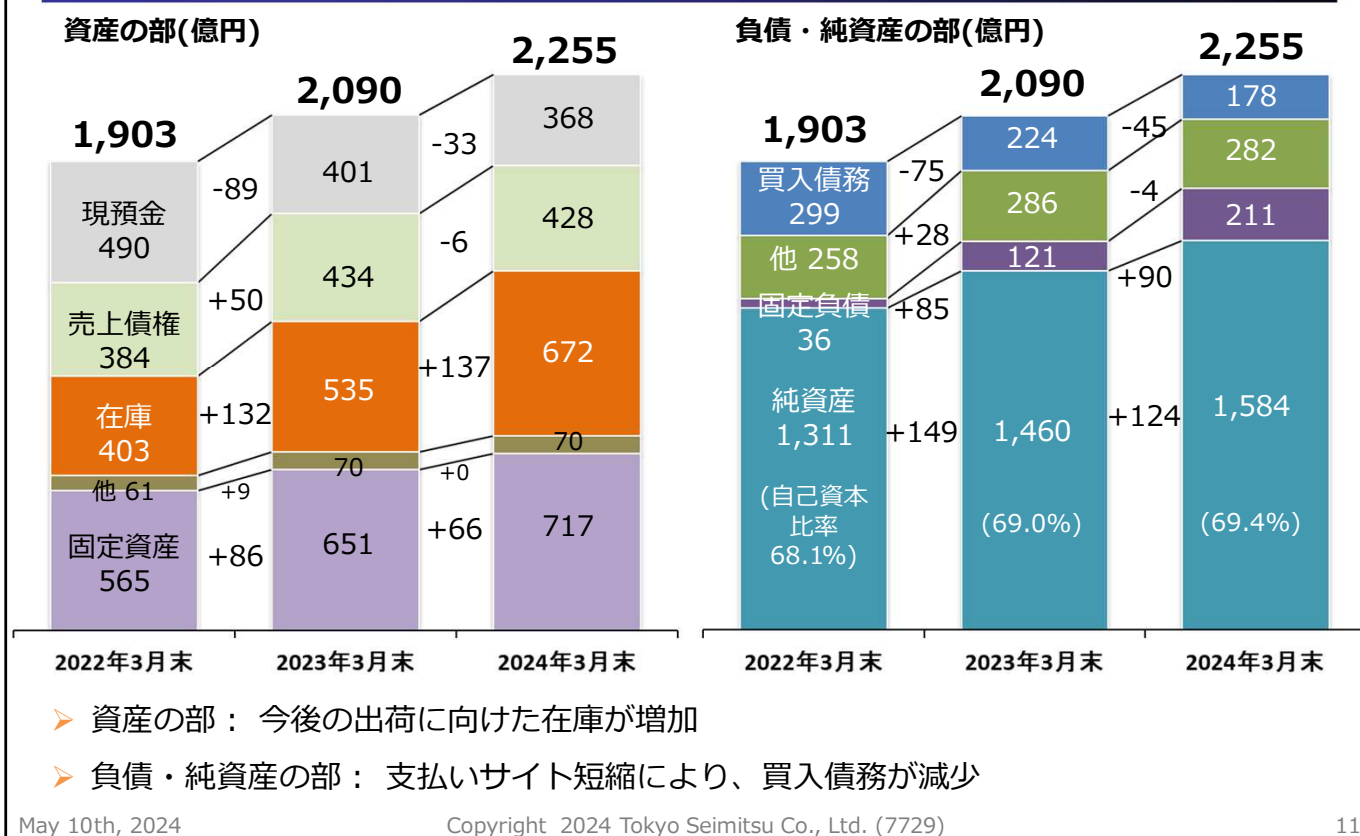


➤ 充放電試験システムの受注構成比が拡大

○ こちらは計測の製品別売上高・受注高の説明です。

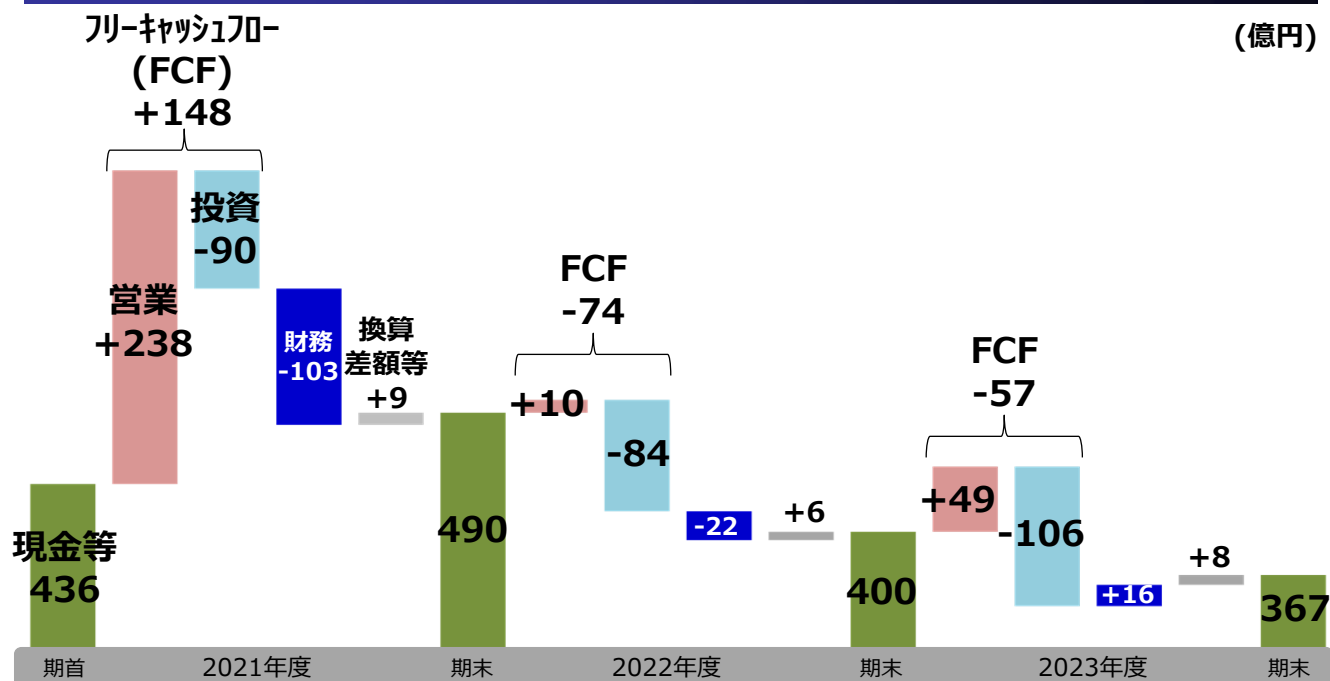
○ 右側、受注高ですが、
充放電試験システムの受注が堅調で、構成比の10%程度まで増加いたしました。

貸借対照表



- 次に、貸借対照表の概要です。
- 左の資産の部ですが、オレンジ色の在庫が前期比で増加しています。
これは、今後の出荷に向けた在庫の増加に加え、長納期部品の先行手配などによります。
- 右側、負債については、支払いサイトの短縮により、青色の買入債務が減少いたしました。
- 3月末の自己資本比率は 69.4%となりました。

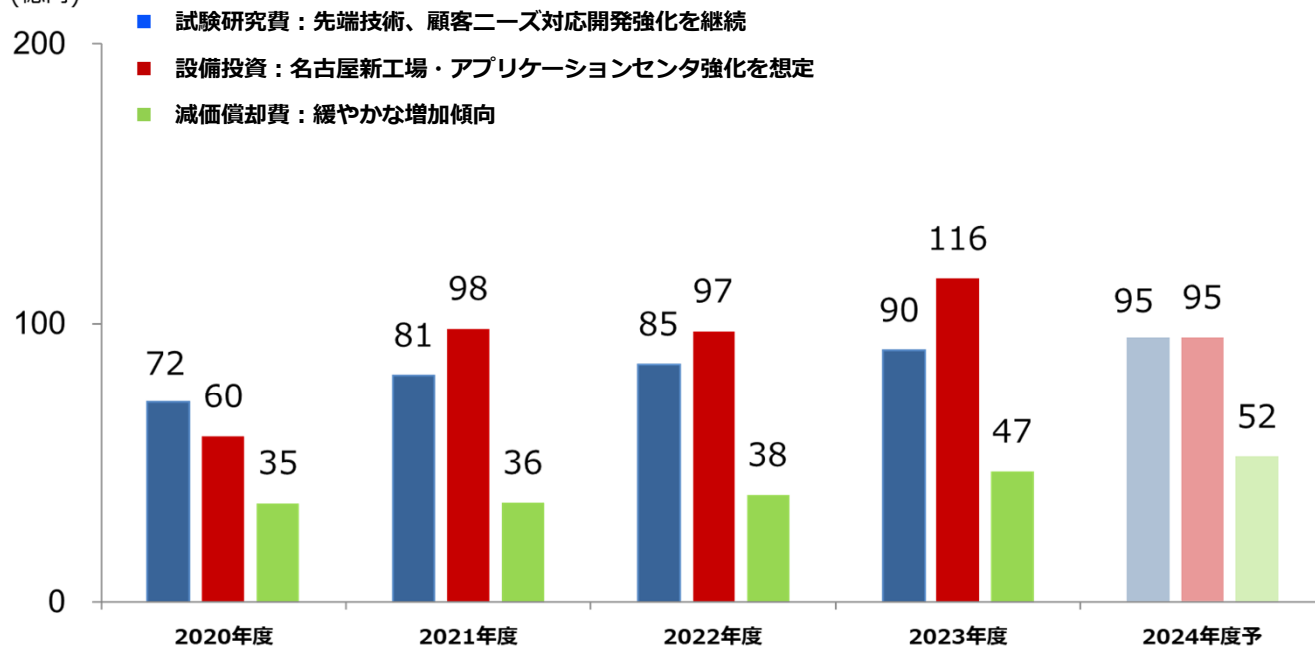
キャッシュフロー(CF)



➤ 買掛金減少、在庫の増加により営業CFは減少

- 次に、キャッシュフローの概要です。右側が2023年度です。
- 2023年度のフリーキャッシュフローはマイナス57億円でした。これは、営業キャッシュフローが、税前利益の減少、ならびに先ほど説明した買掛金の減少・在庫増加などによりプラス49億円となった中、投資活動キャッシュフローが工場建設などによりマイナス106億円となったことによります。

(億円)



➤ 設備投資：2023年計画(145億円)の一部が2024年度へ繰越し

May 10th, 2024

Copyright 2024 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

13

- こちらは、試験研究費、設備投資、減価償却の実績と計画です。
右から2番目のグラフが2023年度の実績です。
- 2023年度の設備投資は 計画145億円に対し、実績が116億円となりましたが
これは一部の投資案件が翌期に繰り越されたことによるもので、
投資計画自体が変更されたものではありません。
- 2024年度の計画ですが、
試験研究費は、開発強化のために増加、
設備投資は、名古屋での新工場の建設により高水準が継続、
減価償却は、2023年竣工の飯能工場の償却などによる増加を計画しています。
- ここまでが、2023年度実績の説明です。

次第

- ◆ 2023年度 業績説明
- ◆ **2024年度 業績予想**
- ◆ 2022-2024年度 中期経営計画 2年目 総括
- ◆ 質疑応答

○ 続いて、2024年度の業績予想に関する説明です。

➤ 2022年5月 計画開示時点の市場前提 (要約)

- Society 5.0による 半導体・電子部品の大量生産/大量消費社会の到来
- 半導体：デバイス製造工程での 後工程重要性の高まり → 新たな成長ステージ
- 計測：内燃機関向け 需要の減少、測定ニーズの変化 → 持続的成長の継続

◆ 現時点での見方

- ◆ 半導体：後工程への重要性の高まりが進むが、大量生産/消費は短期的に停滞
 - プローバの高精度温度制御測定、Hybrid Bonding用グラインダ等
 - 生成AIの新たな事業機会
 - 中国需要は高水準も、台湾を中心とした民生需要が足許では不透明
- ◆ 計測：緩やかな測定ニーズの変化が続く
 - 充放電試験システムの業容拡大
- ◆ 民生関連の需要回復時期を明確に見通せる状況とは言い難い
- ◆ 以上により、今回の業績予想は上期のみとする

- 先に、中期経営計画と、この後説明する業績予想について、説明いたします。
- 上段に、中期経営計画の市場前提を記載しています。
Society5.0による、半導体や電子部品の大量生産・大量消費社会の到来、半導体での、後工程の重要性の高まり、計測での、測定ニーズの変化が前提でした。
- 現時点では、半導体の後工程の重要性は、想定通り高まっているほか新たな事業機会として生成AIが注目されるようになりました。
中国での高水準の需要は続いています。大量消費、すなわち民生関連の需要は台湾を中心に 足許では停滞が続いています。
- 計測では、緩やかな測定ニーズの変化が続いています。
- 全体をみると、想定した市場への変化が続いているものの、民生関係の需要回復時期は引き続き不透明なままで、明確に見通せるとは言い難い状況です。
- したがって、この後お示しする2024年度業績予想は上期のみとさせて頂きたく、ご理解のほどお願いいたします。

半導体

- AI, HBM, SiC, CIS, 中国向け等の需要全体で 前下期と同水準を見込む
 - AI/HBMは、受注時期が明確な案件のみを織り込む
 - SiCは、デバイス加工需要を中心に倍増を想定
- Hybrid Bondingは 2024年度下期より受注に寄与

計測

- 先行指標となる工作機械受注は 前期比 横ばいを見込む
- 当社の注力分野(NEV、ロボット等)で緩やかな市況回復を想定
- EV用バッテリー開発向けに、充放電試験システムの需要が増加

全社

- 中期経営計画の達成に向けた全社取り組みと、先を見越した投資計画を遂行

- 2024年度上期 業績予想の前提がこちらです。
- 半導体では、生成AI、HBM、SiC、イメージセンサ、中国需要がけん引するものと想定しています。
ただし、生成AIとHBMは、前下期と同等の需要が見込まれますが、発注時期の関係から 確度の高い案件のみを織り込んでいます。
SiCは デバイス加工への移行が進み、前年度下期比 倍増の需要を想定しています。
またHybrid Bondingは、2024年度下期の受注に寄与してくると考えています。
- 計測では、先行指標となる 工作機械受注動向自体は 前期比 横ばいを想定していますが、当社が注力するNEV、ロボット等の分野では、市況の回復を想定しています。
バッテリー開発の本格化により、充放電試験システムの需要が増加すると想定しています。
- 全社ベースでは、中期経営計画で策定した取り組みに加えて、今後を見越した名古屋工場建設を 着実に遂行していきます。

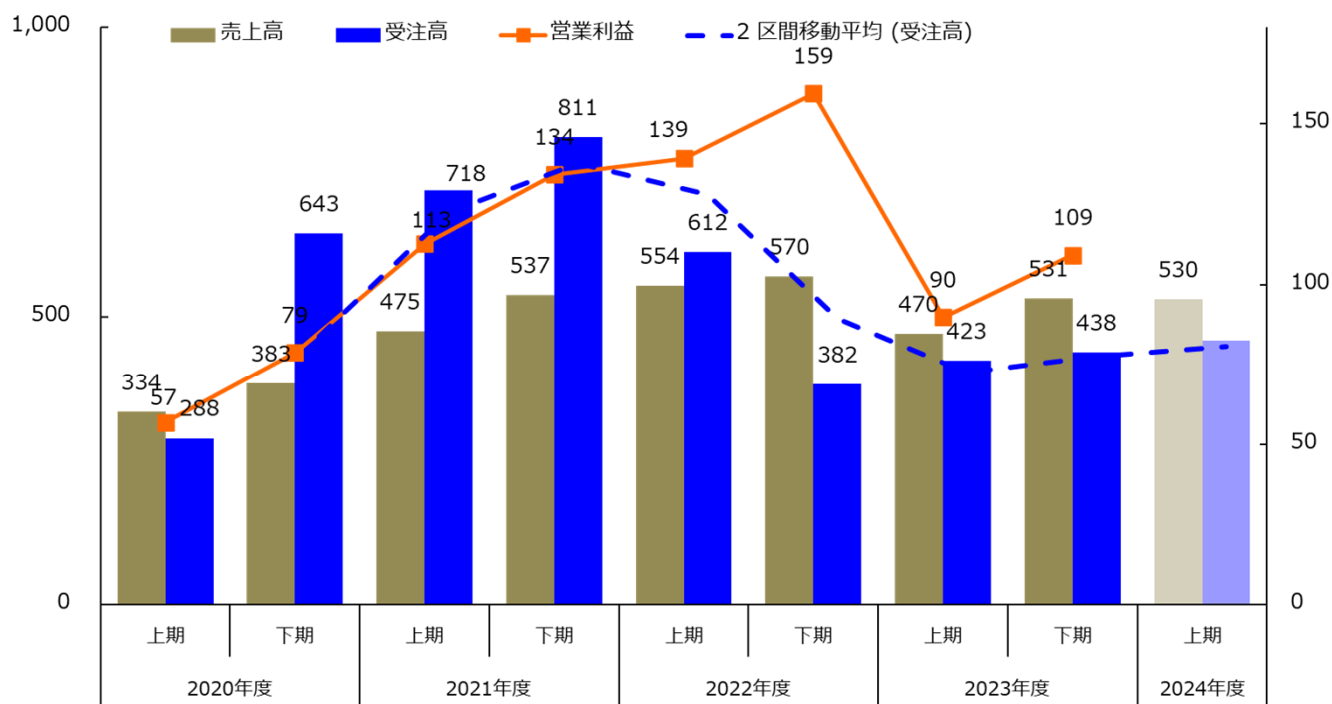
2024年度 業績予想



連結業績 (億円, 円)	2023年度			2024年度予	
	上期	下期	通期	上期予	前年同期比
売上高	635	711	1,347	715	+13%
営業利益 (営業利益率)	114 (18%)	139 (20%)	253 (19%)	140 (20%)	+23%
経常利益	121	144	265	138	+14%
当期純利益	85	108	194	95	+11%
1株配当	89円		192円	95円	+ 6円
セグメント別業績予想			(中間)	(中間)	
(半導体)	受注高	423	438	861	
	売上高	470	531	1,001	530 +13%
(計測)	受注高	172	176	348	
	売上高	166	181	346	185 +12%

- 半導体の民生向け回復タイミングが不透明なことから、上期予想のみ開示
- 前提為替レート 米ドル : 145円

- これらの前提を踏まえた2024年度上期の業績予想はご覧の通りです。
- 売上高 715億円, 営業利益140億円, 経常利益138億円, 当期純利益95億円を見込んでおります。
- 前提為替レートは、1ドルが145円です。
現時点では、1ドル1円で、年間 5 千万円程度の利益影響を想定しています。
- なお配当については、1株95円の中間配当を予想しています。

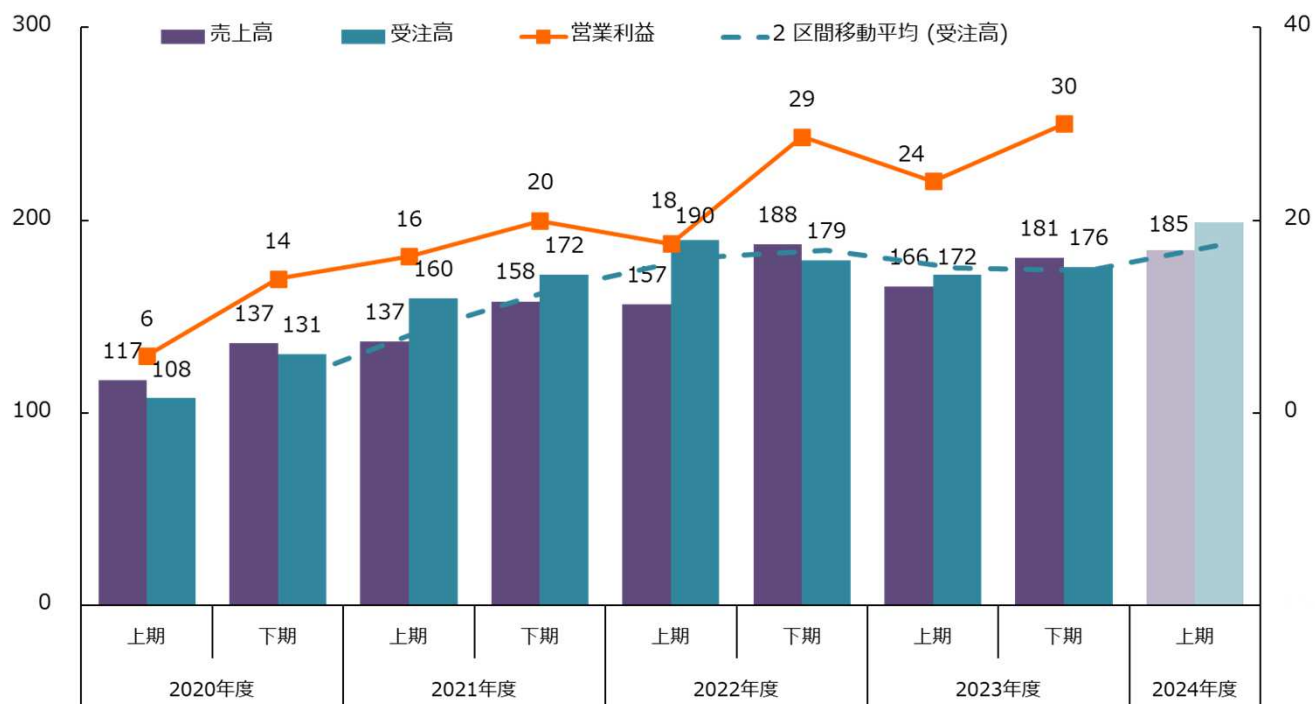


May 10th, 2024

Copyright 2024 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

18

- こちらは、半導体事業の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- 上期の受注は、前年度下期対比 微増から横ばいの水準を想定しています。
先ほど申し上げたように、生成AI関連は受注時期が明確な案件のみを織り込んでいるため
上振れる可能性があります。
- 上期予想の製品構成比は、
受注高は、検査装置 5割半ば、加工装置4割半ば、
売上高は、検査装置 6割、加工装置4割を想定しています。



- こちらは、計測事業の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- 上期の受注は、前年度と同様、ゆるやかな回復基調が続くと見込んでいます。
- 製品構成比は、
受注高、売上高ともに、汎用計測 7割半ば、自動計測が1割半ば、
残りが充放電を想定しています。

次第

- ◆ 2023年度 業績説明
- ◆ 2024年度 業績予想
- ◆ **2022-2024年度 中期経営計画 2年目 総括**
- ◆ 質疑応答

- 次に、2024年度を最終年度とする 中期経営計画について
2年目の総括をご説明いたします。

➤ 2024年度 定量目標を設定

ROE	15%以上
売上高	1,700億円 (半導体1,320億円/計測380億円)
営業利益	375億円 (営業利益率：22%)

➤ 全社取り組み

研究開発投資 先端技術、顧客ニーズ対応開発を強化	生産キャパシティ拡充 飯能工場稼働 (2023年度) SPEキャパシティ 1,400億+α その次の工場投資も検討	環境投資 2030年CO2排出量 50%削減 (2018年度比)に向け 必要な投資を検討
投資評価指標 社内評価基準にROICを検討	アプリケーション強化 各国拠点におけるデモ設備強化	サステナビリティ ESG各取り組み強化

- こちらが、まずは2022年5月に開示した 定量目標です。
上段が定量目標で、下段がそのために策定した 取り組みの一覧です。
- 定量目標の達成は厳しい状況ではありますが、
生産キャパシティの拡張は着実に進めており、民生関連の回復タイミング次第では、
計画達成も可能だと考えております。

研究開発投資	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 精力的な開発を実施 ➢ アブレーションダイサ、プローバ・ダイサ新機種、Hybrid Bonding用グラインダなどを展開
生産キャパシティ拡充	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 飯能工場 稼働 (2023年7月) ➢ 八王子工場のスペース再活用を含め、SPEキャパシティ 1,400億+a の水準を達成 ➢ 次期中期経営計画を見据え 名古屋工場の建設着手
環境投資	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 工場使用電力とCO₂排出量の分析 ➢ 各製品のLCAの削減 (消費電力削減、スループット改善)
投資評価指標	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 事業セグメント別 ROIC評価を開始
アプリケーション強化	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 主要拠点でのデモセンター機能の強化
サステナビリティ (ESG取り組み強化)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ダイバーシティ強化 (女性・障がい者雇用増加 他) ➢ 人権デューデリジェンス及び評価実施 ➢ MSCI BBB → A, FTSE 3.4 維持

- こちらは、6つの主要な取り組みに関する成果をまとめております。
- 上から2番目の生産キャパシティは、次のページで説明します。
- 4番目の投資評価指標ですが、
 2022年度より社内でセグメント別のROICの試算を開始し、
 2023年度も実施いたしました。
 今後は、分析結果に基づき、ROICツリーを策定し、社内へ展開していく予定です。
- 最下段、サステナビリティ、ESG取り組み強化ですが、
 ダイバーシティ、人権デューデリジェンスの取り組みを強化しました。
 また、先ごろ、MSCIのレーティングが、トリプルBより1ランクあがり
 シングル Aとなりましたことを、併せて報告いたします。

- 生産キャパシティ拡張 (工場投資)を計画通り実施
 - 飯能工場竣工 → プローバ生産体制の強化
 - 名古屋工場建設着手 → ハイエンドのグラインダ需要へ対応



飯能工場(埼玉県) 2023年7月稼働
プローバ中心の生産体制



名古屋工場(愛知県) 2025年度稼働予定
グラインダ中心の生産体制

- こちらは設備投資についてまとめたものです。
- 昨年7月 埼玉県の飯能工場が稼働し、プローバの生産体制が大幅にアップしました。これと並行して、八王子工場のスペースを加工装置の生産スペースとして再展開する取り組みをあわせ、半導体で年間1400億円プラスアルファの生産キャパシティを実現いたしました。
- また、今後拡大するグラインダ需要の拡大を見据え、名古屋工場の建設に着手いたしました。

基本的な考え方



中期キャッシュアロケーション 目途

開発費

- 売上高試験研究費比率 10%

設備投資

- 通常時：EBITDA * 25%内
- Max時：EBITDA * 50%
(EBITDA = 営業利益 + 減価償却費)

株主還元

- 配当：配当性向 40%を目安に実施
- 投資動向などを勘案し 自己株取得

M&A等

- FCF マイナスにならないよう配慮

○ こちらは、資本効率に関する考え方を示したものです。

○ 前年からの変更はございませんので、内容は後ほどご覧いただければと思います。

マテリアリティ	2023年度 優先的な取り組み	2024年度 優先的な取り組み
環境問題を解決する製品・事業活動 提供した 製品・サービスによる環境貢献	<ul style="list-style-type: none"> ➢ CO2排出量削減 (設備・機器効率化、太陽光発電導入) ➢ 電力・水・紙使用量削減 ➢ 環境配慮型製品の開発 ➢ 飯能工場の節電・節水 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 気候変動を経営リスクと位置付けた 管理システム構築 ➢ カーボンニュートラルを宣言する ➢ SCOPE1/2削減(2018年度比2030年50%減) ➢ SCOPE3(cat-1/cat-11)削減目標の設定と実行 ➢ 水使用量の削減
社会課題を解決する高付加価値製品 ・サプライチェーンの構築	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 品質管理の高度化 ➢ 化学物質管理の厳格化 ➢ サプライチェーンの強化 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 品質管理の高度化と定着 ➢ 化学物質管理の適切な管理と使用 ➢ サステナブル調達への推進 ➢ サプライヤーエンゲージメントの向上
多様な人々が活躍でき、心身ともに健康で 働き甲斐のある職場づくり	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 健康と安全の向上 ➢ ダイバーシティ推進 ➢ 人財育成推進 ➢ エンゲージメントの向上 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 災害事故0に向けた安全活動推進 ➢ ダイバーシティ推進 ➢ 人財育成推進 ➢ エンゲージメントの向上 ➢ 従業員の健康と安全向上
企業活動を支える経営基盤・ コンプライアンス・ リスクマネジメントの強化	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 内部統制機能の維持・向上 ➢ 企業倫理・法令遵守の厳格化 ➢ 適時・適切な情報開示 ➢ 健全な内部通報制度運営維持 ➢ 効果的なコンプライアンス教育 ➢ 事業継続計画高度化 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 内部統制機能の維持・向上 ➢ 企業倫理・法令遵守の厳格化 ➢ 適時・適切な情報開示 ➢ 健全な内部通報制度運営維持 ➢ 事業継続計画高度化(サプライチェーンへ拡充) ➢ サステナビリティ活動のグループ会社への展開
人権の尊重	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 人権教育の実施 ➢ 人権デューデリジェンスの実施 ➢ 救済システムの構築 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 人権尊重活動強化 ➢ 人権デューデリジェンス拡充 ➢ 救済システムの構築

- こちらは、サステナビリティの取り組みに関して、
2023年度の実施内容と、2024年の取り組み予定を纏めたものになります。
- 環境問題の解決、サプライチェーンの強化などに向けた取り組みを
質、量の両面で高めてゆきたいと考えています。
- 詳細については、後ほどご覧いただければと思います。

プローバ高精度温度制御 → 付加価値の拡大

SiC加工は基板主体からデバイス主体へ

Hybrid bondingによる研削装置の成長

AI関連の需要増加

地政学の変化による需要の増加

NEVバッテリーの飛躍的な個数成長

半導体と計測の融合によるシナジー効果 2025年 130億円超

- 最後に、改めて 当社の今後の成長機会に関して説明させていただきます。
- まず、プローバの高精度温度制御による付加価値の増大です。
複雑なデバイスの検査に対する要求は、さらに高まっており、
大きな事業機会を期待しています。
- SiCでは、基板加工の需要からデバイス加工需要の増加が進むと想定しています。
- ハイブリッドボンディングでは、足許で評価が進んでおり、
中期的に大きな事業機会となりえます。
- このほか、AI関連の需要増、地政学の変化による需要増、
NEVバッテリーの飛躍的な個数成長に伴う 充放電試験システムへの事業機会、
また、半導体と計測の融合によるシナジー効果による 成長に期待しています。
- 以上が私からの説明となります。 ご清聴ありがとうございました。

次第

- ◆ 2023年度 業績説明
- ◆ 2024年度 業績予想
- ◆ 2022-2024年度 中期経営計画 2年目 総括
- ◆ **質疑応答**



IR情報



<https://www.accretech.com/jp/ir/index.html>

サステナビリティ情報



<https://www.accretech.com/jp/sustainability/index.html>

補足資料

Supplementary Data

セグメント別業績推移 Segment Information



(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter								
	2021年 3月期 FY2021/3	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2023年3月期 FY2023/3				2024年3月期 FY2024/3				
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
高 速 半 導 体 部 門 Orders	半導体 SPE	93,181	152,896	99,366	86,082	35,918	25,246	20,663	17,537	20,345	21,957	20,175	23,604
	計測 Metr.	23,878	33,159	36,960	34,802	10,246	8,788	9,472	8,452	9,225	7,981	9,963	7,632
	合計 Total	117,060	186,056	136,326	120,885	46,165	34,034	30,136	25,990	29,571	29,938	30,139	31,236
後 装 部 門 Backlog	半導体 SPE	50,619	102,370	89,371	75,398	117,153	108,134	104,714	89,371	90,993	84,710	87,300	75,398
	計測 Metr.	6,301	9,904	12,428	12,606	13,367	13,263	14,782	12,428	13,758	13,061	15,253	12,606
	合計 Total	56,920	112,274	101,799	88,004	130,520	121,398	119,496	101,799	104,752	97,771	102,553	88,004
半 導 体 部 門 Sales	半導体 SPE	71,745	101,145	112,365	100,055	21,135	34,264	24,084	32,880	18,722	28,241	17,585	35,505
	計測 Metr.	25,359	29,556	34,436	34,624	6,783	8,892	7,954	10,806	7,895	8,678	7,772	10,278
	合計 Total	97,105	130,702	146,801	134,680	27,919	43,156	32,038	43,687	26,618	36,919	25,357	45,784
業 務 利 損 Op	半導体 SPE	13,565	24,698	29,866	19,899	5,049	8,874	6,416	9,526	3,208	5,773	1,912	9,004
	計測 Metr.	1,996	3,628	4,628	5,408	641	1,120	1,031	1,834	1,042	1,365	1,084	1,916
	合計 Total	15,562	28,327	34,494	25,307	5,691	9,994	7,448	11,361	4,250	7,138	2,997	10,921
業 務 利 損 率 Op Margin	半導体 SPE	18.9%	24.4%	26.6%	19.9%	23.9%	25.9%	26.6%	29.0%	17.1%	20.4%	10.9%	25.4%
	計測 Metr.	7.9%	12.3%	13.4%	15.6%	9.5%	12.6%	13.0%	17.0%	13.2%	15.7%	14.0%	18.6%
	合計 Total	16.0%	21.7%	23.5%	18.8%	20.4%	23.2%	23.2%	26.0%	16.0%	19.3%	11.8%	23.9%

損益計算書 Statements of Income



(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter							
	2021年 3月期 FY2021/3	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2023年3月期 FY2023/3				2024年3月期 FY2024/3			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高 Net Sales	97,105	130,702	146,801	134,680	27,919	43,156	32,038	43,687	26,618	36,919	25,357	45,784
売上原価 Cost of goods sold	60,190	77,694	84,967	79,917	15,940	25,783	18,220	25,022	15,415	22,387	14,894	27,220
売上総利益 Gross Profit on Sales	36,914	53,008	61,834	54,762	11,978	17,372	13,817	18,664	11,203	14,531	10,462	18,564
販売費および一般管理費 Selling, general and administrative expenses	21,351	24,681	27,339	29,454	6,287	7,378	6,369	7,303	6,952	7,392	7,465	7,643
営業利益 Operating profit	15,562	28,327	34,494	25,307	5,691	9,994	7,448	11,361	4,250	7,138	2,997	10,921
営業外収益 Non-operating income	540	987	965	1,404	824	96	-229	274	563	245	52	541
営業外費用 Non-operating expenses	235	153	162	259	18	25	111	7	103	22	64	67
経常利益 Recurring Profit	15,867	29,160	35,297	26,453	6,496	10,065	7,107	11,628	4,710	7,361	2,985	11,394
特別利益 Extraordinary gains	1,354	390	103	824	5	58	12	25	26	-	3	794
特別損失 Extraordinary losses	1,074	34	2,099	21	-	-	1,751	347	-	14	-	7
税引前利益 Profit before income taxes and minority interests	16,147	29,516	33,301	27,255	6,502	10,124	5,368	11,306	4,736	7,347	2,989	12,181
法人税等合計 Total income tax and others	3,978	8,132	9,607	7,791	1,660	3,019	2,011	2,916	1,456	1,998	897	3,437
親会社株主に帰属する当期純利益 Net Profit attributable to Owners of the Parent	12,175	21,326	23,630	19,378	4,812	7,096	3,338	8,383	3,245	5,302	2,067	8,763
1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (Yen)	293.83	522.52	581.33	480.49	118.38	174.47	82.05	206.60	80.63	131.49	51.23	217.00
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (diluted) (Yen)	291.43	517.51	575.62	475.42	-	-	-	-	-	-	-	-

貸借対照表 Balance Sheet



(百万円) (Million Yen)		2021年3月期 FY2021/3	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3
流動資産 Current Assets	現金及び預金 Cash and cash equivalents	43,657	49,033	40,080	36,782
	売上債権※1 Accounts Receivable※1	30,946	38,367	43,403	42,801
	在庫 Inventories	32,886	40,325	53,482	67,225
	その他 Others	4,025	6,103	7,005	7,022
	合計 Total	111,516	133,829	143,972	153,831
	固定資産合計 Total Fixed Assets	50,039	56,457	65,060	71,693
	総資産 Total Assets	161,556	190,287	209,032	225,524
流動負債 Current Liabilities	買入債務※2 Accounts Payable※2	23,062	29,876	22,359	17,845
	その他 Others	16,233	25,765	28,588	28,156
	合計 Total	39,296	55,641	50,947	46,002
	固定負債合計 Total long-term liabilities	5,482	3,564	12,057	21,094
	負債合計 Total Liabilities	44,778	59,206	63,004	67,097
	純資産合計 Total Net Assets	116,777	131,081	146,028	158,427
	負債・純資産合計 Total Liabilities and Net Assets	161,556	190,287	209,032	225,524
	有利子負債合計 Total interest-bearing debt	7,581	5,497	14,191	25,171
	自己資本比率 Equity Ratio(%)	71.4%	68.1%	69.0%	69.4%
	自己資本利益率 ROE(%)	10.9%	17.4%	17.3%	12.9%

※1: 電子記録債権、契約資産を含む

Incl. Electronically recorded monetary claims

※2: 電子記録債務を含む

Incl. Electronically recorded obligations-operating

各種費用, キャッシュフロー Expenses and Cash Flows

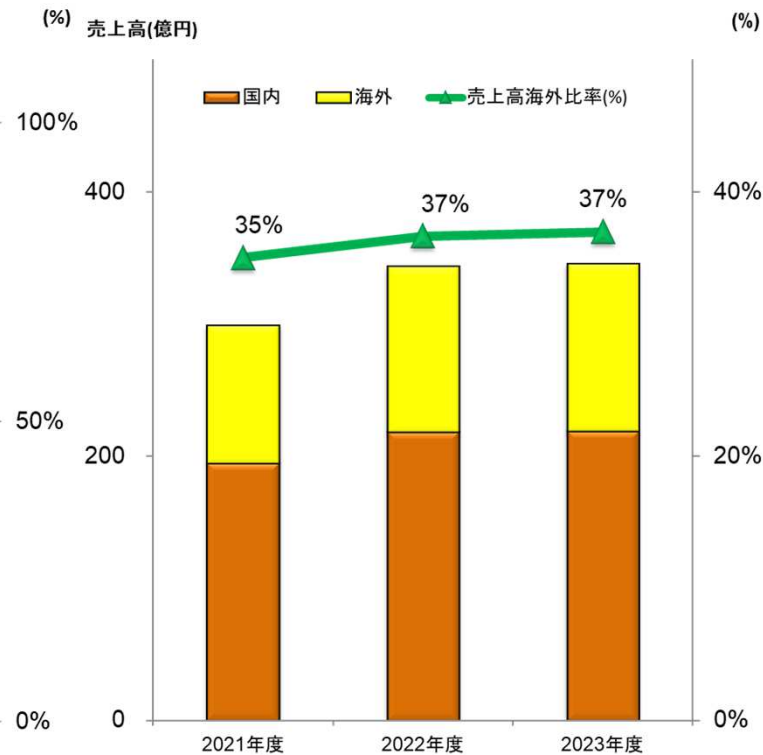
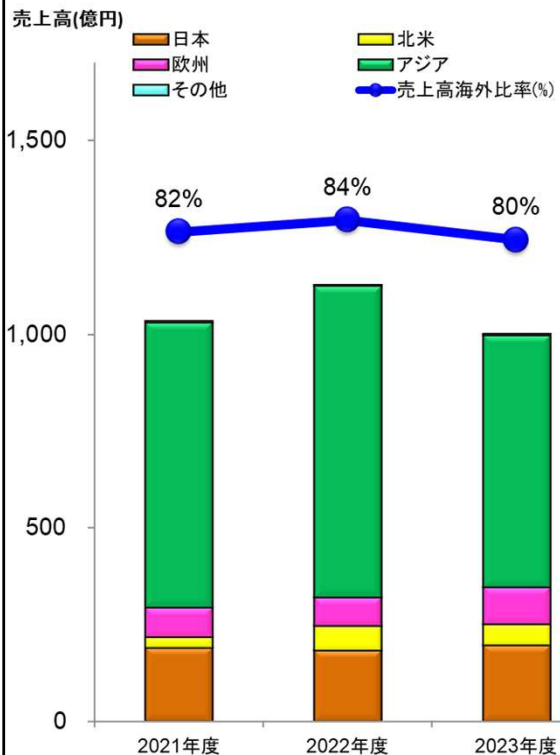


(百万円) (Million Yen)	2021年3月期 FY2021/3	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3
試験研究費 R&D expenses	7,193	8,146	8,542	9,042
設備投資 Capex	5,950	9,793	9,725	11,602
減価償却費 (のれん除く) Depreciation (excl. Amortization)	3,516	3,551	3,832	4,673

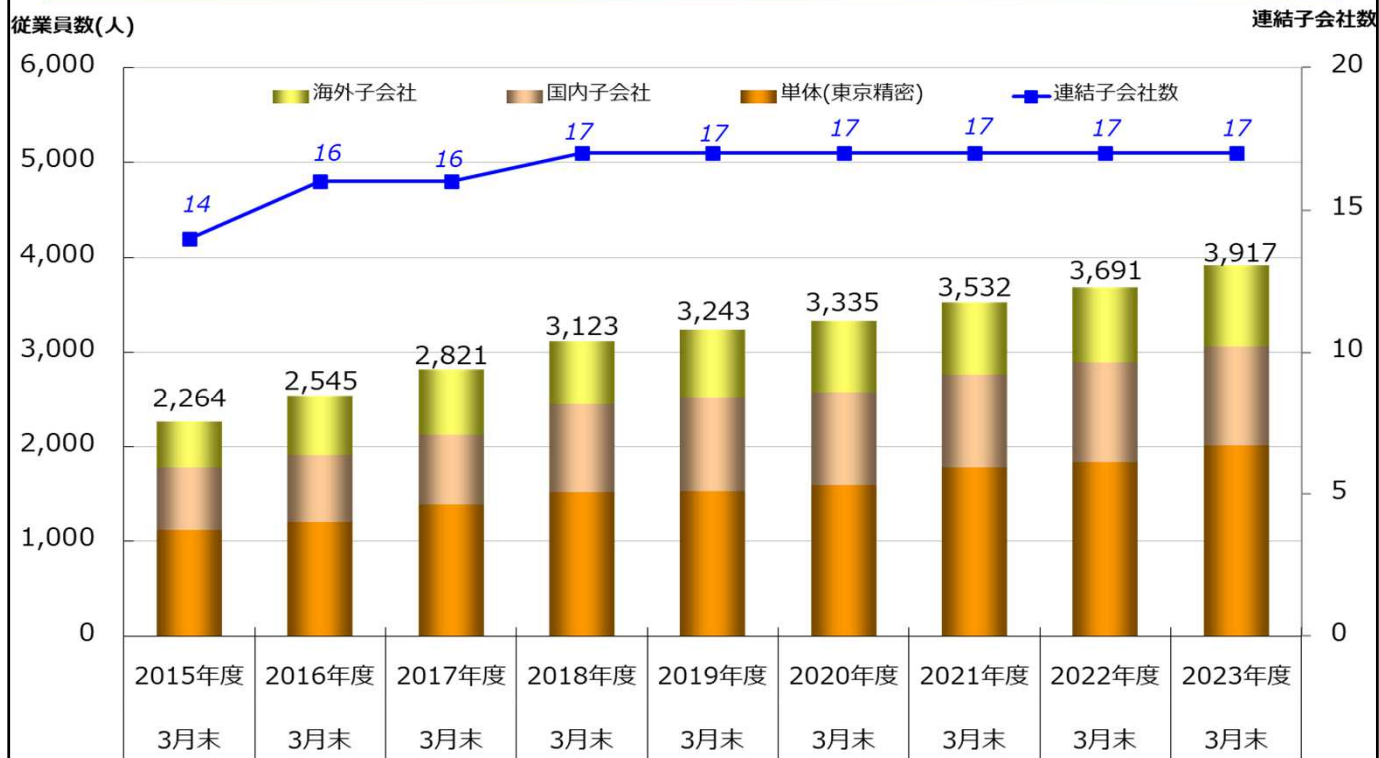
(百万円) (Million Yen)	2021年3月期 FY2021/3	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3
営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	22,062	23,837	1,000	4,892
投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	-5,191	-8,990	-8,421	-10,563
フリーキャッシュフロー Free cash flows	16,871	14,846	-7,421	-5,671
財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities	-8,282	-10,346	-2,174	1,616
現金及び現金同等物に係る換算差額等 Adjustments	429	882	625	755
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at the end of year	43,624	49,006	40,036	36,736

半導体製造装置

精密計測機器



従業員推移



注) 上記従業員は、正社員と期末時点の臨時従業員の単純合算